

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2026-077

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中微半导体设备（上海）股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股53,486,224股，每股发行价格为人民币29.01元，股款以人民币缴足，计人民币155,163.54万元，扣除承销及保荐费用共计人民币8,782.84万元后，实际收到募集资金计人民币146,380.69万元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计1,810.41万元后，实际募集资金净额为人民币144,570.28万元（以下简称“首发募集资金”），上述资金于2019年7月16日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2019）第0411号验资

报告。

2、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

中国证券监督管理委员会于2021年3月3日出具证监许可[2021]645号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准了公司向特定对象发行80,229,335股人民币普通股A股股票。截至2021年6月22日止，公司完成了人民币普通股A股80,229,335股的发行，每股发行价格为人民币102.29元，股款以人民币缴足，合计人民币820,665.87万元，扣除承销及保荐费用共计人民币8,206.66万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币812,459.21万元，再扣除其他发行费用人民币合计642.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币811,816.24万元（以下简称“再融资募集资金”），上述资金于2021年6月22日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2021）第0638号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金

中国证券监督管理委员会于2026年5月11日出具证监许可[2026]1147号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准了公司向特定对象发行5,156,765股人民币普通股A股股票。截至2026年6月17日止，公司完成了人民币普通股A股5,156,765股的发行，每股发行价格为人民币290.88元，股款以人民币缴足，合计人民币149,999.98万元，扣除承销及保荐费用共计人民币954.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币149,045.98万元，再扣除其他发行费用人民币合计57.86万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币148,988.12万元（以下简称“配套募集资金”），上述资金于2026年6月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2026）第0016号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019 年 7 月 16 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	155,163.54
其中：超募资金金额	44,570.28
减：直接支付发行费用	10,593.26
二、募集资金净额	144,570.28
减：	
以前年度已使用金额	130,061.20
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	18,991.95
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
募投项目结项资金转出	4,425.06
增值税税金	620.00
加：	
募集资金利息收入	9,548.75
其他	
三、报告期期末募集资金余额	20.24

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 6 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	820,665.87
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,849.63
二、募集资金净额	811,816.24
减：	
以前年度已使用金额	680,793.15
本年度使用金额	27,932.71
暂时补流金额	-
现金管理金额	148,336.90
银行手续费支出及汇兑损益	1.64
加：	
募集资金利息收入	45,736.82
其他	422.28
三、报告期期末募集资金余额	910.94

单位：万元 币种：人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2026 年 6 月 17 日
本次报告期	2026 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	149,999.98
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,011.86
二、募集资金净额	148,988.12
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	954.00
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
加：	
募集资金利息收入	-
其他	1,011.86
三、报告期期末募集资金余额	149,045.98

二、募集资金管理情况

中微公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《中微公司：募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2019 年 7 月 16 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	20.24	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行上海金桥支行	121910890310602	-	已注销

中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	-	已注销
-------------------	------------	---------------------	---	-----

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2021 年 6 月 22 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行上海分行	121910890310707	80.13	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	143.58	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	633.82	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	53.40	使用中

单位：万元 币种：人民币

发行名称		发行股份购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间		2026 年 6 月 17 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	国家开发银行上海分行	310001090000000100378	38,338.89	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000011938	76,004.51	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	平安银行上海分行营业部	15001217560061	34,702.57	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。

本报告期公司募投项目先期投入及置换情况见下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 6 月 22 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
中微产业化基地建设项目	317,000.00	-	-	不适用	2025 年 8 月 28 日
中微临港总部和研发中心项目	375,000.00	10,999.13	10,999.13	2026 年	2025 年 8 月 28 日
科技储备资金	119,816.24	-	-	不适用	2025 年 8 月 28 日

单位：万元 币种：人民币

发行名称		发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2026 年 6 月 17 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端半导体设备产业化项目	38,338.89	-	-	不适用	2026 年 8 月 19 日
高端半导	34,702.57	-	-	不适用	2026 年 8

体设备研发中心项目					月19日
支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	6,004.51	-	不适用	2026年8月19日
补充流动资金	70,000.00	-	-	不适用	2026年8月19日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
180,000	安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品	2026年4月28日	2027年4月27日	2026年3月30日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2019 年 7 月 16 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计年化 收益率	利息金 额
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	18,000.00	11/11/2025	2/9/2026	2/9/2026	0.00	1.65%	77.67
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	18,000.00	3/12/2026	6/10/2026	6/10/2026	0.00	1.65%	73.23
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	协定存款	协定存款	18,991.95	7/16/2025	7/15/2026	不适用	18,991.95	0.53%	13.40

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年向特定对象公开发行股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 22 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计年化 收益率	利息金 额
中微半导体设备（上海）股份有限公司	国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	七天通知存款	16,949.47	无固定期限	无固定期限	不适用	16,949.47	1.55%	529.91

中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	24,363.75	无固定期限	无固定期限	不适用	24,363.75	1.95%	
南昌中微半导体设备有限公司	招商银行股份有限公司南昌高新支行	协定存款	协定存款	361.51	无固定期限	无固定期限	不适用	361.51	1.50%	0.20
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	七天通知存款	4,000.00	无固定期限	无固定期限	不适用	4,000.00	1.35%	
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	协定存款	协定存款	1,997.01	无固定期限	无固定期限	不适用	1,997.01	0.35%	3.36
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国进出口银行上海分行	协定存款	协定存款	353.48	无固定期限	无固定期限	不适用	353.48	0.45%	0.70
中微半导体设备（上海）股份有限公司	国家开发银行股份有限公司上海市分行	协定存款	协定存款	1,801.13	无固定期限	无固定期限	不适用	1,801.13	0.45%	3.35
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	协定存款	21,188.63	无固定期限	无固定期限	不适用	21,188.63	0.35%	39.64
中微半导体设备（上海）股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	协定存款	16,554.38	无固定期限	无固定期限	不适用	16,554.38	0.45%	37.81
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	协定存款	1,347.46	无固定期限	无固定期限	不适用	1,347.46	0.45%	0.34
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	协定存款	10,419.83	无固定期限	无固定期限	不适用	10,419.83	0.35%	18.41

海)股份有限公司	公司上海市浦东开 发区支行									
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	中国光大银行股份 有限公司上海隆昌 支行	协定存款	协定存款	3,618.15	无固定期限	无固定期限	不适用	3,618.15	0.45%	8.27
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	兴业银行股份有限 公司上海人民广场 支行	协定存款	协定存款	143.67	无固定期限	无固定期限	不适用	143.67	0.45%	0.23
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	上海银行股份有限 公司张江支行	协定存款	协定存款	238.45	无固定期限	无固定期限	不适用	238.45	0.53%	0.52
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	光大银行隆昌支行	七天通知存款	七天通知存款	7,000.00	无固定期限	无固定期限	不适用	7,000.00	0.75%	
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	光大银行隆昌支行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	12/31/2025	3/31/2026	3/31/2026		1.65%	33.00
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	中信银行上海浦东 分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	1/1/2026	1/30/2026	1/30/2026		1.70%	27.01
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	中信银行上海浦东 分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2/1/2026	2/28/2026	2/28/2026		1.70%	25.15
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	中信银行上海浦东 分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/1/2026	3/31/2026	3/31/2026		1.62%	14.14
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	中信银行上海浦东 分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/1/2026	5/29/2026	5/29/2026		1.60%	41.45
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	中信银行上海浦东 分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	4/1/2026	4/30/2026	4/30/2026		1.70%	13.51
中微半导体设备(上 海)股份有限公司	中信银行上海浦东 分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	5/1/2026	5/29/2026	5/29/2026		1.65%	12.66

中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	6/3/2026	9/3/2026	不适用	20,000.00	1.65%	
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	1/6/2026	1/30/2026	1/30/2026		1.54%	10.13
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2/2/2026	2/27/2026	2/27/2026		1.55%	10.62
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/3/2026	3/31/2026	3/31/2026		1.60%	12.27
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	4/7/2026	4/30/2026	4/30/2026		1.62%	9.01
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	6/3/2026	9/1/2026	不适用	10,000.00	1.50%	
中微半导体设备（上海）股份有限公司	光大银行隆昌支行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	4/1/2026	7/1/2026	不适用	8,000.00	1.60%	

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将再融资募集资金中微产业化基地建设项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于日常生产经营活动。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目不存在变更、对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2019 年 7 月 16 日										
本年度投入募集资金总额			-										
已累计投入募集资金总额			130,061.20										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端半导体设备扩产升级项	生产建设	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	39,991.03	-8.97	99.98%	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2020 年向特定对象公开发行股票									
募集资金到账日期				2021 年 6 月 22 日									
本报告期投入募集资金总额				27,932.71									
已累计投入募集资金总额				708,725.86									
变更用途的募集资金总额				-									
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中微产业化基地建设项目	生产建设	无	317,000.00	317,000.00	317,000.00	9,193.99	282,791.26	-34,208.74	89.21%	不适用	不适用	不适用	否
中微临港总部和研发中心项目	生产建设、研发项目	无	375,000.00	375,000.00	375,000.00	18,738.72	306,118.35	-68,881.65	81.63%	不适用	不适用	不适用	否

科技储备资金	研发项目	无	308,000.00	119,816.24	119,816.24	-	119,816.24	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计			1,000,000.00	811,816.24	811,816.24	27,932.71	708,725.86	-103,090.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因						详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）”。							
募集资金其他使用情况						不适用。							

单位：万元 币种：人民币

发行名称				发行股份购买资产并募集配套资金									
募集资金到账日期				2026 年 6 月 17 日									
本报告期投入募集资金总额				954.00									
已累计投入募集资金总额				954.00									
变更用途的募集资金总额				-									
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端半导体设备产业化项目	生产建设	无	38,338.89	38,338.89	38,338.89	-	-	-38,338.89	-	不适用	不适用	不适用	否
高端半导体设备研发中心项目	研发项目	无	34,702.57	34,702.57	34,702.57	-	-	-34,702.57	-	不适用	不适用	不适用	否

支付现金对价及中介机构费用	现金对价、发行费用	无	6,958.53	6,958.53	6,958.53	954.00	954.00	-6,004.53	13.71%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-70,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			150,000.00	150,000.00	150,000.00	954.00	954.00	-149,046.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因						本报告期不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况						不适用。							

注 1：公司发行股份购买资产并募集配套资金拟投入项目中包含了“支付中介机构费用”项目，因此募集资金总额未扣除发行费用。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账时扣除的承销费用。